

MultiPrep 200

Copper Adhesion Promoter

ソルダーレジスト、ドライフィルム、 フォトレジストとの優れた接着性

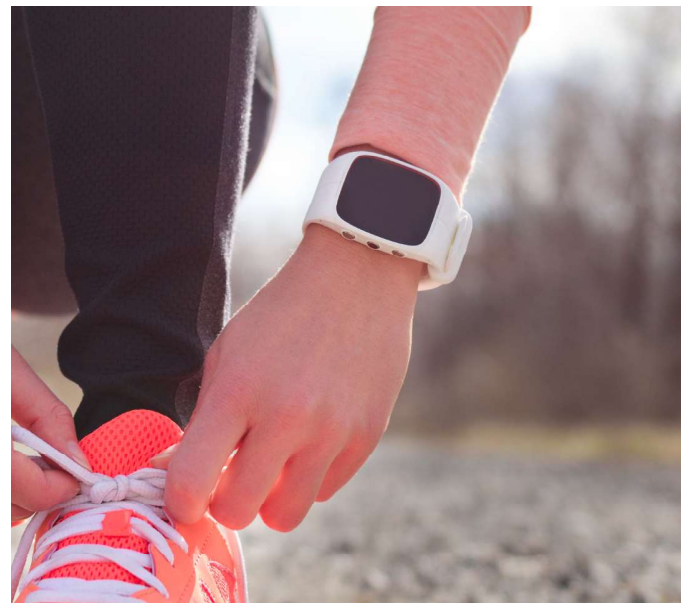
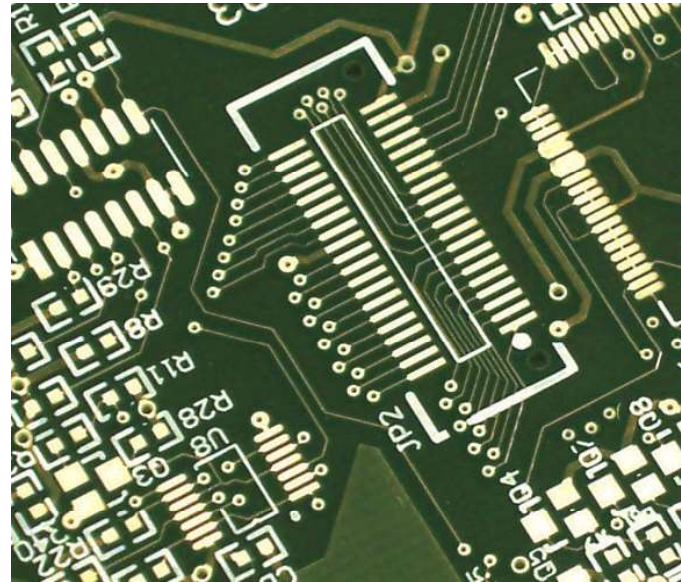
MultiPrep 200密着性向上処理プロセスは、ソルダーレジスト、ドライフィルム、液状フォトレジストを銅表面に密着させる為に理想的な銅表面状態を形成します。

MultiPrep 200は、ジェットスクラブやブラシによる研磨を不要とし、優れた均一な表面形状を提供します。

MultiPrep 200は、優れた粗化形状により、ビアフィルめっきとPTHめっき間の高い接続信頼性と、マイクロビアや微細パターンへのソルダーレジストの良好な密着性が得られます。

MultiPrep 200プロセスは、ソルダーレジスト塗布に適した優れた銅表面粗化表面を提供します。さらに、ENIG、シルバー、OSP、置換錫等を含む全ての最終表面処理に適合します。

MultiPrep 200を選択する事で、すべての放熱用穴埋め樹脂、塗布膜やフィルムとの優れた銅の接着が可能です。



KEY FEATURES

- ・ 浴寿命が長く、浴管理も容易。
- ・ 密着性の高い微細粗化形状。
- ・ 均一な外観。

 **MacDermid Enthone**

CIRCUITRY SOLUTIONS

MultiPrep 200

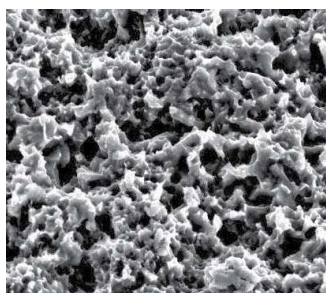
Copper Adhesion Promoter

ソルダーレジストやフォトレジストとの優れた接着を実現するカスタマイズされた微細粗化処理プロセス

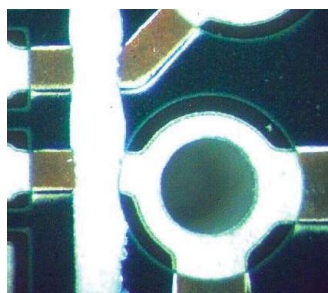
MultiPrep 200は、銅エッチングに関する他の多くのプロセスを最適化する為の、数十年に及ぶMacDermid Enthoneの経験から生まれました。MultiPrep 200を使用する事で、プロセスが信頼性、且つ耐久性があり、結果としてすべてのレベルでのサプライチェーンで承認を得る事が可能です。

MultiPrep 200は、高密度な回路基板のマイクロビアや微細構造に優れたマイクロエッチング形状を与え、すべての表面処理に適しており、完璧なの均一性とクリーンで安定した外観を提供します。

MultiPrep 200

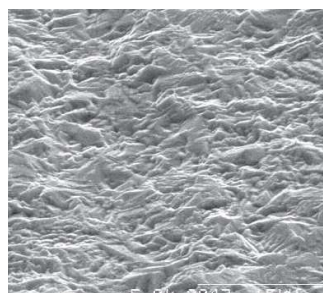


SEM at 5K x,
Zygoによる表面粗さ:
Ra=0.58 μm Rz=5.2 μm

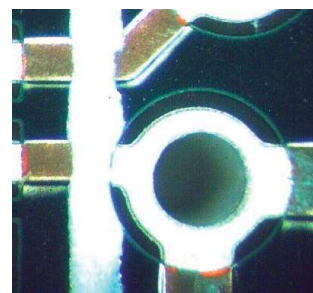


ソルダーレジスト、フォトレジスト密着のための均一な粗化形状
(置換スズめっき後のテープテストによる密着性良好)

比較品



SEM at 5K x,
Zygoによる表面粗さ:
Ra=0.03 μm Rz=0.36 μm



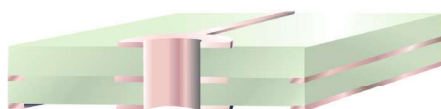
置換スズめっき後のテープテストによりソルダーレジストの剥がれ発生

MultiPrep 200のアプリケーション

ドライフィルム、液状フォトレジスト前処理



ソルダーレジスト前エッチング処理



マイクロビア内の樹脂埋め前粗化処理



macdermidalpha.com

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions. © 2020 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved. "(R)" and "TM" are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS